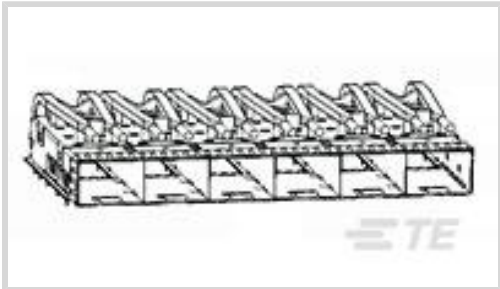




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片



外形尺寸: zSFP+

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

数据速率（最大值）: 32 Gb/s

[所有 zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
外形尺寸	zSFP+
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

端口数量	6
端口矩阵配置	1 x 6

电气特征

数据速率（最大值）	32 Gb/s
-----------	---------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	2.05 mm[.081 in]

壳体特性

笼子材料	镍/银合金
------	-------

尺寸

PCB 厚度（建议）	2.25 mm[.089 in]
------------	------------------

操作/应用

--	--



插拔式 I/O 应用	zSFP+ 热增强型
兼容的散热器	否
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号YD369-HP33-NS10000

369 HARSH 3 WAY PLUG, CRIMP, SKT



TE 产品编号1-2364573-6

AVH19 FLT SS LK R+P GRN 24V26A



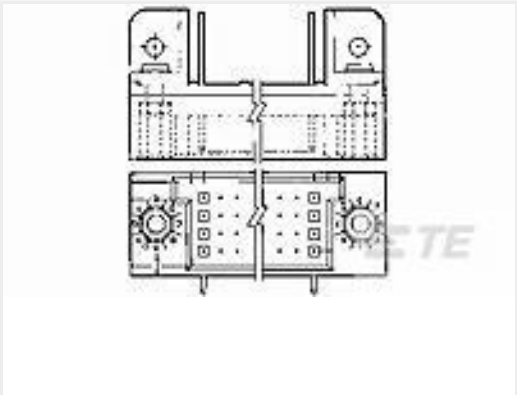
TE 产品编号1-530743-4

MINI BOX PIN HDR ASY 40 POS



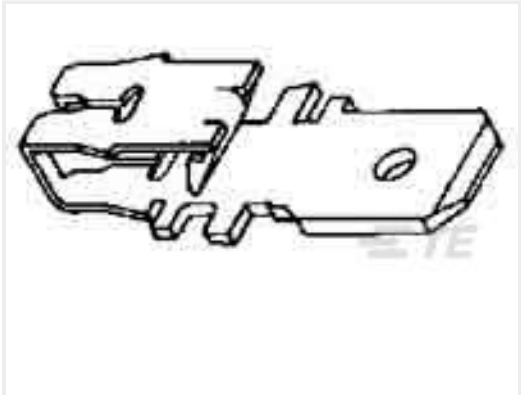
TE 产品编号2170746-2

CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, LP



TE 产品编号533286-9

HDI PIN ASSY 4 ROW 240 POS R/A



TE 产品编号1742160-1

TAB,187 FASTON,MAG-MATE



TE 产品编号2842154-5

10P,2MM,BRK HDR,DRRT,2.8,0.1AU, TB W/CAP



TE 产品编号91556-3

CCII AMP EI SERIES 26-20 HEAD



TE 产品编号2-2319764-0

E STACK PIANO 10P G SHORT TUBE PD OFF



TE 产品编号4-2176379-5

RQ 0805 309R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2227731-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2227731-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2227731-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

zSFP+ Interconnect Brochure

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本